

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

公告编号：<欣>2017-011

欣旺达电子股份有限公司

关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月13日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

因公司经营和业务发展需要，公司拟以位于深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧欣旺达新能源产业基地厂房A、B、C及宿舍楼（粤2016深圳市不动产权第0155021号）作为抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币9亿元的综合授信额度，授信期限为壹年。公司将根据自身运营的实际需求确定具体授信额度的使用。

截止2016年12月31日，本次抵押资产的合计账面价值为368,436,065.77元，占公司最近一期经审计净资产的17.59%。

公司本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年1月13日